

X570 AORUS PRO

X570 AORUS PRO

WIFI

使用手册

Rev. 1001

12MSC-X57APRO-1001R

X570 AORUS
PRO



X570 AORUS
PRO WIFI



更详尽的产品相关信息，请连接至技嘉网站查询。



为减缓地球暖化效应，本产品包装材料都可回收再利用，技嘉与您一同为环保尽一份力！

Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer,

G.B.T. Technology Trading GmbH

Address: Bußenkoppel 16, 22047 Hamburg, Germany

Declare that the product

Product Type: **Motherboard**

Product Name: **X570 AORUS PRO**

conforms with the essential requirements of the following directives:

☒ **EMC Directive 2014/53/EU:**

☒ Conduction & Radiated Emissions:	EN 55032:2012+AC:2013
☒ Immunity:	EN 55024:2010+A1:2015
☒ Power-line harmonics:	EN 61000-3-2:2014
☒ Power-line flicker:	EN 61000-3-3:2013

☒ **Low Voltage Directive 2014/35/EU:**

☒ Safety:	EN60950-1:2006+A11:2009+A12:2011+A2:2013
---	--

☒ **RoHS Directive 2011/65/EU**

☒ Restriction of use of certain substances in electronic equipment:	This product does not contain any of the restricted substances listed in Annex II, in concentrations and applications banned by the directive.
---	--

☒ **CE marking**



Signature: Timmy Huang

(Date)

Date: Jun. 3, 2019

Name: Timmy Huang

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)



Responsible Party Name: **G.B.T. INC. (U.S.A.)**

Address: **17358 Railroad Street**

City of Industry, CA 91748

Phone/Fax No: (626) 854-9338/ (626) 854-9326

hereby declares that the product

Product Name: Motherboard

Model Number: X570 AORUS PRO

Conforms to the following specifications:

FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109 (a), Class B Digital Device

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful and (2) this device must accept any interference received, including that may cause undesired operation.

Representative Person's Name: ERIC LU

Signature: Eric Lu

Date: Jun. 3, 2019

版权

© 2019年, 技嘉科技股份有限公司, 版权所有。

本使用手册所提及的商标与名称, 均属其合法注册的公司所有。

责任声明

本使用手册受著作权保护, 所撰写的内容均为技嘉所拥有。

本使用手册所提及的产品规格或相关信息, 技嘉保留修改的权利。

本使用手册所提及的产品规格或相关信息有任何修改或变更时, 恕不另行通知。

未事先经由技嘉书面允许, 不得以任何形式复制、修改、转载、传送或出版本使用手册内容。

■ 如果您要快速安装, 可以参考包装内所附的【硬件安装指南】。

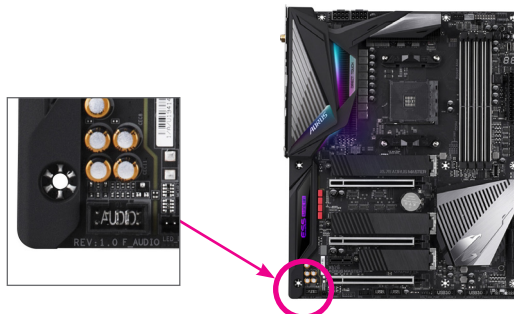
■ 为了协助您使用技嘉主板, 请仔细阅读【使用手册】。

■ 产品相关信息, 请至网站查询: <https://www.gigabyte.cn>

产品版本辨识

您可以在主板上找到标示着此主板的版本「REV : X.X」。其中X.X为数字, 例如标示「REV : 1.0」, 意即此主板的版本为1.0。当您更新主板的BIOS、驱动程序或参考其他技术数据时, 请注意产品版本的标示。

范例:



Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer,

G.B.T. Technology Trading GmbH

Address: Bullenköppel 16, 22047 Hamburg, Germany

Declare that the product

Product Type: **Motherboard**

Product Name: **X570 AORUS PRO WIFI**

conforms with the essential requirements of the following directives:

☒ **EMC Directive 2014/30/EU:**

☒ Conduction & Radiated Emissions:	EN 55032:2012+AC2013
☒ Immunity:	EN 55024:2010+A1:2015
☒ Power-line harmonics:	EN 61000-3-2:2014
☒ Power-line flicker:	EN 61000-3-3:2013

☒ **Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU:**

☒ Safety:	EN 62368-1:2014
	EN 50566:2017

☒ **Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU:**

Wireless module model name:	AX200NGW
Wireless module manufacturer:	Intel Mobile Communications SAS
☒ Technical Requirements:	EN 300 328 v2.1.1, EN 301893 v2.1.1, EN 300 400 v2.2.1 EN 301 489-1 v2.2.0, EN 301 489-17 v3.2.0.

☒ **RoHS Directive 2011/65/EU**

☒ Restriction of use of certain substances in electronic equipment:	This product does not contain any of the restricted substances listed in Annex II, in concentrations and applications banned by the directive.
---	--

☒ **CE marking**



Signature: Timmy Huang

(Date)

Date: Jun. 3, 2019

Name:

Timmy Huang

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)



Responsible Party Name: **G.B.T. INC. (U.S.A.)**

Address: **17358 Railroad Street**

City of Industry, CA 91748

Phone/Fax No: (626) 854-9338/ (626) 854-9326

hereby declares that the product

Product Name: Motherboard

Model Number: X570 AORUS PRO WIFI

Conforms to the following specifications:

FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109 (a), Class B Digital Device

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful and (2) this device must accept any interference received, including that may cause undesired operation.

Representative Person's Name: ERIC LU

Signature: Eric Lu

Date: Jun. 3, 2019

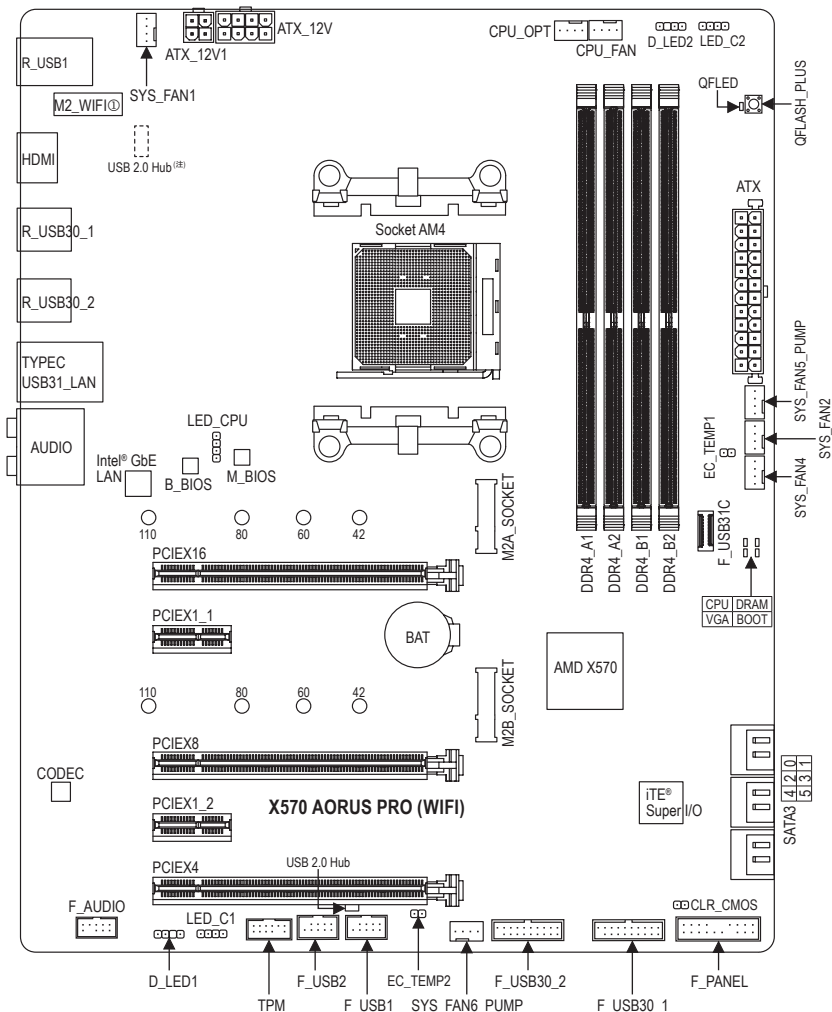
无线设备国家 / 地区认证:

United States: FCC: PD9AX200NG	Japan: 003-190022 D190021003 5.15~5.35GHz indoor use only	Singapore Complies with IMDA standards DB 02941
Canada: IC: 1000M-AX200NG		Serbia:
Australia & New-Zealand: 	South Korea: R-C-INT-AX200NGW 1.상호명: Intel Corporation 2.기자재의 명칭 (모델명): 특정소출력 무선기기(무선랜을 포함한 무선접속시스템용 무선기기) AX200NGW 3.제조사: 2019/02 4.제조사/제조국: Intel Corporation/China	Taiwan:
European Union: 		Ukraine:

目录

X570 AORUS PRO (WIFI)主板配置图	5
第一章 硬件安装	6
1-1 安装前的注意事项	6
1-2 产品规格	7
1-3 安装中央处理器	11
1-4 安装内存模块	11
1-5 安装扩充卡	12
1-6 构建AMD CrossFire™/NVIDIA® SLI™系统	12
1-7 后方设备接口介绍	13
1-8 插座及跳线介绍	15
第二章 BIOS 程序设置	25
2-1 开机画面	25
2-2 BIOS设置程序主画面	26
2-3 Favorites (F11) (最爱设置)	27
2-4 Tweaker (频率/电压控制)	28
2-5 Settings (设置)	30
2-6 System Info. (系统信息)	35
2-7 Boot (开机功能设置)	36
2-8 Save & Exit (储存设置值并结束设置程序)	39
第三章 附录	40
3-1 构建磁盘阵列	40
3-2 驱动程序安装	42
管理声明	43
技嘉主板售后服务及质量保证卡	51
技嘉科技全球服务网	52

X570 AORUS PRO (WIFI) 主板配置图



清点配件

- ☑ X570 AORUS PRO或X570 AORUS PRO WIFI 主板 - 1片
- ☑ 驱动程序光盘 - 1片
- ☑ 使用手册 - 1本
- ☑ 硬件安装指南 - 1本
- ☑ RGB LED灯带延长线 - 1条
- ☑ SATA 排线 - 4条
- ☑ 天线 - 1支①
- ☑ M.2螺丝/M.2螺柱
- ☑ G Connector - 1个

* 上述附带配件仅供参考，实际配件请以实物为准，技嘉科技保留修改的权利。

① 只有X570 AORUS PRO (WIFI)提供此功能。

(注) 此芯片位于主板背面。

第一章 硬件安装

1-1 安装前的注意事项

主板是由许多精密的集成电路及其他元件所构成，这些集成电路很容易因静电影响而损坏。所以在安装前请先仔细阅读此使用手册并做好下列准备：

- 安装前请确认所使用的机箱尺寸与主板相符。
- 安装前请勿任意撕毁主板上的序列号及代理商保修贴纸等，否则会影响到产品保修期限的认定标准。
- 要安装或移除主板以及其他硬件设备之前请务必先关闭电源，并将电源线自插座中拔除。
- 安装其他硬件设备至主板内的插座时，请确认接口和插座已紧密结合。
- 拿取主板时请尽量不要触碰金属接线部份以避免线路发生短路。
- 拿取主板、中央处理器(CPU)或内存条时，最好戴上防静电手环。若无防静电手环，请确保双手干燥，并先碰触金属物以消除静电。
- 主板在未安装之前，请先置放在防静电垫或防静电袋内。
- 当您连接或拔除主板电源插座上的插头时，请确认电源供应器是关闭的。
- 在开启电源前请确定电源供应器的电压值是设置在所在区域的电压标准值。
- 在开启电源前请确定所有硬件设备的排线及电源线都已正确地连接。
- 请勿让螺丝接触到主板上的线路或零件，避免造成主板损坏或故障。
- 请确定没有遗留螺丝或金属制品在主板上或电脑机箱内。
- 请勿将电脑主机放置在不平稳处。
- 请勿将电脑主机放置在温度过高或潮湿的环境中。
- 在安装时若开启电源可能会造成主板、其他设备或您自己本身的伤害。
- 如果您对执行安装不熟悉，或使用本产品发生任何技术性问题时，请咨询专业的技术人员。
- 使用转接器、延长线或电线时，请查阅其安装及接地相关说明。

1-2 产品规格

 中央处理器(CPU)	AMD AM4插槽, 支持: 第三代AMD Ryzen™处理器/ 第二代AMD Ryzen™处理器/ 第二代AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics处理器/ AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics处理器 (请至技嘉网站查询有关支持的处理器列表)
 芯片组	AMD X570
 内存	- 第三代AMD Ryzen™处理器: - 支持DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 MHz - 第二代AMD Ryzen™处理器/第二代AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics处理器/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics处理器: - 支持DDR4 2933/2667/2400/2133 MHz 4个DDR4 DIMM插槽, 可高达128 GB (单一插槽支持32 GB容量) - 支持双通道内存技术 - 支持ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8内存 - 支持non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16内存 - 支持Extreme Memory Profile (XMP)内存 (请至技嘉网站查询有关支持的内存模块速度及列表)
 显示功能 ^(注一)	- 基于有显示功能的处理器: 1个HDMI插座, 可支持高达4096x2160@60 Hz的分辨率 * 支持HDMI 2.0版本、HDCP 2.2及HDR。 - 支持最大共用显示内存至16 GB
 音频	- 集成Realtek® ALC1220-VB芯片 * 后方音频插座提供的音频输出孔支持DSD音频信号。 - 支持High Definition Audio - 支持2/4/5.1/7.1声道 - 支持S/PDIF输出
 网络	集成Intel® GbE 网络芯片(10/100/1000 Mbit)
 无线通讯模块 ^①	- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, 支持2.4/5 GHz无线双频 - BLUETOOTH 5.0 - 支持11ax 160MHz无线通信标准, 可支持高达2.4 Gbps * 实际传输速度将因使用环境及设备而有所差异。

① 只有X570 AORUS PRO WIFI提供此功能。

(注一) 只有第二代AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics处理器/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics处理器支持此功能。

 扩展插槽	基于CPU (PCIEX16/PCIEX8): • 第三代AMD Ryzen™处理器: - 1个PCI-E x16插槽支持PCI-E 4.0及x16运行规格(PCIEX16) - 1个PCI-E x16插槽支持PCI-E 4.0及x8运行规格(PCIEX8) • 第二代AMD Ryzen™处理器: - 1个PCI-E x16插槽支持PCI-E 3.0及x16运行规格(PCIEX16) - 1个PCI-E x16插槽支持PCI-E 3.0及x8运行规格(PCIEX8) * 为发挥显卡最大性能, 安装一张显卡时务必安装至PCIEX16插槽。 * 由于PCIEX8插槽与PCIEX16插槽共享带宽, 所以当使用第三代/第二代AMD Ryzen™处理器和PCIEX8插槽安装显卡时, PCIEX16插槽最高以x8带宽运行。 • 第二代AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics处理器/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics处理器: - 1个PCI-E x16插槽支持PCI-E 3.0及x8运行规格(PCIEX16) 基于芯片组(PCIEX4/PCIEX1): - 1个PCI-E x16插槽支持PCI-E 4.0 (注二)/3.0及x4运行规格(PCIEX4) - 2个PCI-E x1插槽支持PCI-E 4.0 (注二)/3.0
 多重显示技术 (注三)	• 支持 NVIDIA® Quad-GPU SLI™及2-Way NVIDIA® SLI™技术 • 支持 AMD Quad-GPU CrossFire™及2-Way AMD CrossFire™技术
 储存设备介面	基于CPU (M2A_SOCKET): • 第三代AMD Ryzen™处理器: - 1个M.2插槽支持Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA及PCI-E 4.0 x4/x2 SSD • 第二代AMD Ryzen™处理器/第二代AMD Ryzen™ with Radeon™ Graphics处理器/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics处理器: - 1个M.2插槽支持Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA及PCI-E 3.0 x4/x2 SSD 基于芯片组(M2B_SOCKET): - 1个M.2插槽支持Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA及PCI-E 4.0 (注二)/3.0 x4/x2 SSD - 6个SATA 3.0接口 - 支持RAID 0、RAID 1及RAID 10功能
 USB	• 基于CPU: - 3个USB 3.2 Gen 1接口在后窗IO - 1个USB 3.2 Gen 2 (注二)/Gen 1 Type-A接口(红色)在后窗IO • 基于芯片组: - 1个USB Type-C™接口, 支持USB 3.2 Gen 2, 需经由排线从主板内USB接口接出 - 1个USB Type-C™接口在后窗IO, 支持USB 3.2 Gen 2 - 1个USB 3.2 Gen 2 Type-A接口(红色)在后窗IO - 4个USB 3.2 Gen 1接口需经由排线从主板内USB接口接出 • 基于芯片组+USB 2.0 Hub: - 8个USB 2.0/1.1接口(4个在后窗IO, 4个需经由排线从主板内USB接口接出)

(注二) 只有第三代AMD Ryzen™处理器支持此功能。

(注三) 只有第三代AMD Ryzen™处理器/第二代AMD Ryzen™处理器支持此功能。

	内接插座	◆ 1个24PIN 主板供电插座 ◆ 1个8PIN CPU 供电插座 ◆ 1个4PIN CPU 供电插座 ◆ 1个CPU风扇插座 ◆ 1个CPU水冷风扇插座 ◆ 3个系统风扇插座 ◆ 2个系统风扇/水泵插座 ◆ 2个可编程LED灯带电源插座 ◆ 2个RGB LED灯带电源插座 ◆ 1个散热风扇灯带/RGB LED灯带电源插座 ◆ 2个M.2 SSD插座 ◆ 6个SATA 3.0插座 ◆ 1个主板跳线插座 ◆ 1个前置音频插座 ◆ 1个USB Type-C™插座, 支持USB 3.2 Gen 2 ◆ 2个USB 3.2 Gen 1插座 ◆ 2个USB 2.0/1.1插座 ◆ 1个安全加密模块(TPM)插座(2x6 pin, 限搭配GC-TPM2.0_S使用) ◆ 1个清除CMOS数据跳线 ◆ 2个感温线针脚 ◆ 1个Q-Flash Plus按钮
	后窗IO设备 连接接口	◆ 2个SMA天线接口(2T2R)① ◆ 1个HDMI接口 ◆ 1个USB Type-C™接口, 支持USB 3.2 Gen 2 ◆ 1个USB 3.2 Gen 2 (注二)/Gen 1 Type-A接口(红色) ◆ 1个USB 3.2 Gen 2 Type-A接口(红色) ◆ 3个USB 3.2 Gen 1接口 ◆ 4个USB 2.0/1.1接口 ◆ 1个RJ-45网线接口 ◆ 1个数字光纤输出接口 ◆ 5个音频接口
	I/O控制器	◆ 集成iTE® I/O 控制芯片
	硬件监控	◆ 电压检测 ◆ 温度检测 ◆ 风扇转速检测 ◆ 水冷系统流速检测 ◆ 过温警告 ◆ 风扇故障警告 ◆ 智能风扇控制 * 是否支持智能风扇(水泵)控制功能会依不同的散热风扇(水泵)而定。
	BIOS	◆ 2个128 Mbit flash ◆ 使用经授权AMI UEFI BIOS ◆ 支持DualBIOS™ ◆ PnP 1.0a、DMI 2.7、WfM 2.0、SM BIOS 2.7、ACPI 5.0

① 只有X570 AORUS PRO WIFI提供此功能。

(注二) 只有第三代AMD Ryzen™处理器支持此功能。

	附加工具程序 ♦ 支持APP Center * APP Center 支持的程序会因不同主板而有所差异; 各程序所支持的功能也会依主板的规格而不同。 - @BIOS - AutoGreen - Cloud Station - EasyTune - Fast Boot - Game Boost - ON/OFF Charge - RGB Fusion - Smart Backup - Smart Keyboard - Smart Survey - System Information Viewer - USB Blocker ♦ 支持Q-Flash Plus ♦ 支持Q-Flash ♦ 支持Xpress Install
	附赠软件 ♦ Norton® Internet Security (OEM版本) ♦ cFosSpeed ♦ XSplit Gamecaster + Broadcaster (1年期)
	操作系统 ♦ 支持Windows 10 64-bit
	规格 ♦ ATX规格; 30.5cmx 24.4cm

* 产品规格或相关信息技嘉保留修改的权利, 有任何修改或变更时, 恕不另行通知。

X570 AORUS PRO



X570 AORUS PRO
WIFI



请至技嘉网站查询处理器、内存模块、SSD及M.2设备支持列表。



请至技嘉网站「支持\工具程序」页面下载最新的工具程序。

1-3 安装中央处理器



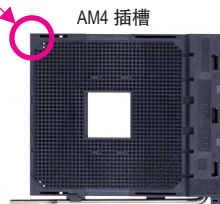
在开始安装中央处理器(CPU)前, 请注意以下的信息:

- 请确认所使用的CPU是在此主板的支持范围。
(请至技嘉网站查询有关支持的CPU列表)
- 安装CPU之前, 请务必将电源关闭, 以免造成损毁。
- 请确认CPU的第一针脚位置, 若方向错误, CPU会无法放入CPU插槽内。
- 请在CPU表面涂抹散热膏。
- 在CPU散热风扇未安装完成前, 切勿启动电脑, 否则过热会导致CPU的损毁。
- 请依据您的CPU规格来设置频率, 我们不建议您将系统速度设置超过硬件的标准范围, 因为这些设置对于集成外设而言并非标准规格。如果您要将系统速度设置超出标准规格, 请评估您的硬件规格, 例如: CPU、显卡、内存、硬盘等来设置。

安装中央处理器(CPU)

请先确认主板上CPU插槽的第一针脚(小三角形)位置及CPU的第一针脚(小三角形)位置。

插槽上的小三角形记号
为第一针脚位置



AM4 插槽

CPU上的小三角形记号
为第一针脚位置



AM4 CPU

1-4 安装内存模块



在开始安装内存模块前, 请注意以下的信息:

- 请确认所使用的内存模块规格是在此主板的支持范围, 建议您使用相同容量、厂牌、速度、颗粒的内存模块。
(请至技嘉网站查询有关支持的内存模块速度及列表)
- 在安装内存模块之前, 请务必将电源关闭, 以免造成损毁。
- 内存模块有防呆设计, 若插入的方向错误, 内存模块就无法安装, 此时请立刻更改插入方向。

双通道内存技术

此主板配置4个内存模块插槽并支持双通道内存技术(Dual Channel Technology)。安装内存模块后, BIOS会自动检测内存的规格及其容量。当使用双通道内存时, 内存前端总线的带宽会增加为原来的两倍。

4个内存模块插槽分为两组通道(Channel):

- ▶▶ 通道A (Channel A): DDR4_A1, DDR4_A2
- ▶▶ 通道B (Channel B): DDR4_B1, DDR4_B2



请至技嘉网站查询更详尽的硬件安装说明。

▶▶可启动双通道内存的组合如下表：

	DDR4_A1	DDR4_A2	DDR4_B1	DDR4_B2
2支内存模块	--	DS/SS	--	DS/SS
	DS/SS	--	DS/SS	--
4支内存模块	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS

(SS：单面，DS：双面，--：没有安装内存)

由于CPU的限制，若要使用双通道内存技术，在安装内存模块时需注意以下说明：

1. 如果只安装一支内存模块，无法启动双通道内存技术。
2. 如果要安装两支或四支内存模块，建议您使用相同的内存模块(即相同容量、厂牌、速度、颗粒)。为发挥最大性能，如果要安装两支DDR4内存模块启动双通道内存技术，建议安装至DDR4_A2及DDR4_B2插槽。

1-5 安装扩充卡



在开始安装扩充卡前，请注意以下的信息：

- 请确认所使用的扩充卡规格是在此主板的支持范围，并请详细阅读扩充卡的使用手册。
- 在安装扩充卡之前，请务必将电源关闭，以免造成损毁。

1-6 构建AMD CrossFire™/NVIDIA® SLI™ 系统^(注一)

A. 系统需求

- 操作系统Windows 10 64-bit
- 具备两个以上PCI-E x16插槽和支持CrossFire/SLI功能的主板以及其驱动程序
- 具备相同品牌、相同型号和支持CrossFire/SLI功能的显卡以及其驱动程序
- CrossFire^(注二)/SLI连接器
- 电力足够的电源供应器 (所需瓦特数，请参考显卡使用手册)

B. 连接显卡

步骤一：

参考「1-5安装扩充卡」章节的步骤将显卡分别安装至主板上的PCIEX16及PCIEX8插槽。

步骤二：

将CrossFire^(注二)/SLI连接器两端的插槽分别插入显卡上缘的金手指部份。

步骤三：

将显示器的接口接至安装于PCIEX16插槽上的显卡。

C. 设置显卡驱动程序

C-1. 启动CrossFire设置

在操作系统中安装完显卡的驱动程序后，进入「Radeon 设置」画面。浏览至「游戏\全域设置」画面，确认「AMD CrossFire」功能已经开启。

C-2. 启动SLI设置

在操作系统中安装完显卡的驱动程序后，进入「NVIDIA控制面板」画面。请浏览至「设置SLI、环场音频、PhysX」画面，并确认已启用「最大化3D性能」。

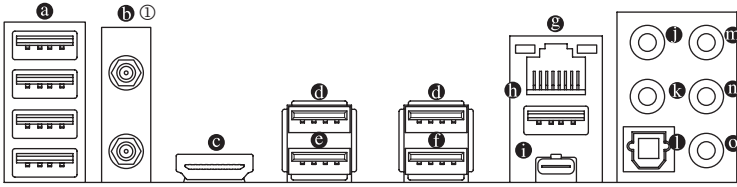
(注一) 只有第三代AMD Ryzen™处理器/第二代AMD Ryzen™处理器支持此功能。

(注二) 是否需要此连接器，依显卡而定。



启动CrossFire/SLI技术的步骤及驱动程序画面，可能会因不同显卡及驱动程序版本而异，详细信息请参考显卡使用手册的说明。

1-7 后方设备接口介绍



a USB 2.0/1.1接口

此接口支持USB 2.0/1.1规格, 您可以连接USB设备至此接口。

b SMA天线接口(2T2R)①

连接天线至此接口。



将天线锁至天线接口, 完成安装后将天线移至收讯良好处。

c HDMI 接口(注一)



此接口可兼容于HDCP 2.2规格并和支持Dolby TrueHD及DTS HD Master Audio音频信号格式, 可支持高达192KHz/24bit 8-channel LPCM音频输出。

您可以连接支持HDMI接口的显示器至此接口。HDMI技术可支持高达至4096x2160@60 Hz的分辨率, 实际所支持的分辨率会依您所使用的显示器而有不同。



当您安装HDMI设备后, 请将音频播放的预设设备设为HDMI (此选项名称会因不同操作系统而有不同)。

d USB 3.2 Gen 1接口

此接口支持USB 3.2 Gen 1规格, 并可兼容于USB 2.0规格。您可以连接USB设备至此接口。

e USB 3.2 Gen 1 接口(白色)

此接口支持USB 3.2 Gen 1规格, 并可兼容于USB 2.0规格。您可以连接USB设备至此接口。执行Q-Flash Plus (注二)时, 请将U盘连接至此接口。

f USB 3.2 Gen 2 (注三)/Gen 1 Type-A接口(红色)

此接口支持USB 3.2 Gen 2 (注三)/Gen 1规格, 并可兼容于USB 3.2 Gen 1及USB 2.0规格。您可以连接USB设备至此接口。

g 网络接口(RJ-45)

此网络接口是超高速以太网网络(Gigabit Ethernet), 提供连线至互联网, 传输速率最高每秒可达1 GB (1 Gbps)。网络接口指示灯说明如下:

连线/速度
指示灯

运行指示灯



网络插座

连线/速度指示灯:

灯号状态	说明
亮橘色灯	传输速率 1 Gbps
亮绿色灯	传输速率 100 Mbps
灯灭	传输速率 10 Mbps

运行指示灯:

灯号状态	说明
闪烁	传输数据中
灯亮	无传输数据

① 只有X570 AORUS PRO WIFI提供此功能。



- 要移除连接于各接口上的连接线时, 请先移除设备端的接口, 再移除连接至主板端的接口。
- 移除连接线时, 请直接拔出, 切勿左右摇晃接口, 以免造成接口内的线路短路。

⑪ USB 3.2 Gen 2 Type-A接口(红色)

此接口支持USB 3.2 Gen 2规格,并可兼容于USB 3.2 Gen 1及USB 2.0规格。您可以连接USB设备至此接口。

⑫ USB Type-C™ 接口

此接口支持USB 3.2 Gen 2规格和采用可正反插的设计,并可兼容于USB 3.2 Gen 1及USB 2.0规格。您可以连接USB设备至此接口。

⑬ 中央及重低音输出

此插孔可提供中央及重低音声道输出。

⑭ 后喇叭输出

此插孔可提供后置环绕声道输出。

⑮ 数字光纤输出接口

此接口提供数位音频输出至具有光纤传输功能的音频系统,使用此功能时须确认您的音频系统具有光纤数位输入插座。

⑯ 音频输入/侧喇叭输出

此插孔为音频输入孔。外接光驱、随身听及其他音频输入设备可以接至此插孔。

⑰ 音频输出/前置喇叭输出

此插孔为音频输出孔和支持音频扩大功能,建议将耳机与喇叭接至此插孔以获得上佳输出音频(实际效果可能会因您所使用的设备而有不同)。

⑱ 麦克风/侧喇叭输出

此插孔为麦克风连接孔。

音频连接孔设定如下:

接口	耳机/2声道	4声道	5.1声道	7.1声道
⑪ 中央及重低音输出			✓	✓
⑭ 后喇叭输出		✓	✓	✓
⑯ 音频输入/侧喇叭输出				✓
⑰ 音频输出/前置喇叭输出	✓	✓	✓	✓
⑱ 麦克风/侧喇叭输出				✓



- 若要连接侧喇叭,需经由音频软件将音频输入或麦克风孔设置为侧喇叭功能。
- 若要启动及设置音频输出孔的音频扩大功能,请至高保真音频管理程序设置。



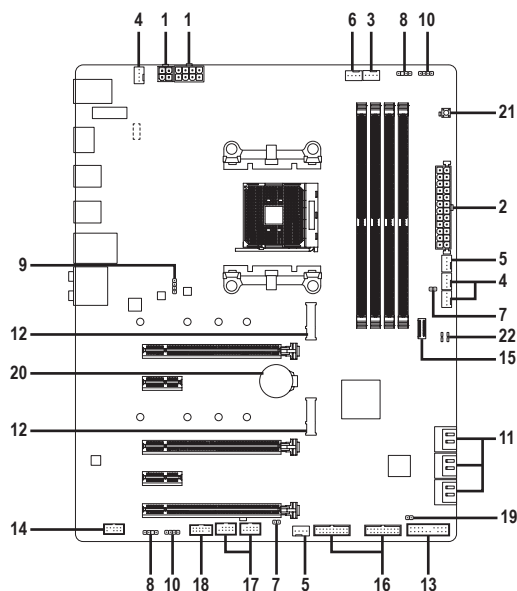
请至技嘉网站查询音频软件的设置说明。

(注一) 只有第二代AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics处理器/AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics处理器支持此功能。

(注二) 若要启动Q-Flash Plus功能,请至技嘉网站查询「产品功能介绍」的说明。

(注三) 只有第三代AMD Ryzen™处理器支持此功能。

1-8 插座及跳线介绍



1) ATX_12V1/ATX_12V	12) M2A_SOCKET/M2B_SOCKET
2) ATX	13) F_PANEL
3) CPU_FAN	14) F_AUDIO
4) SYS_FAN1/2/4	15) F_USB31C
5) SYS_FAN5_PUMP/SYS_FAN6_PUMP	16) F_USB30_1/F_USB30_2
6) CPU_OPT	17) F_USB1/F_USB2
7) EC_TEMP1/EC_TEMP2	18) TPM
8) D_LED1/D_LED2	19) CLR_CMOS
9) LED_CPU	20) BAT
10) LED_C1/LED_C2	21) QFLASH_PLUS
11) SATA3 0/1/2/3/4/5	22) CPU/DRAM/VGA/BOOT



连接各种外接硬件设备时, 请注意以下的信息:

- 请先确认所使用的硬件设备规格与想连接的插座符合。
- 在安装各种设备之前, 请务必将设备及电脑的电源关闭, 并将电源线自插座中拔除, 以免造成设备的损毁。
- 安装好设备想开启电源前, 请再次确认设备的接口与插座已紧密结合。

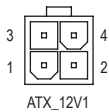
1/2) ATX_12V1/ATX_12V/ATX (4PIN, 8PIN CPU 供电插座及24PIN 主板供电插座)

通过电源插座可使电源供应器提供足够和稳定的电源给稳主板上的所有元件。在插入电源插座前, 请先确定电源供应器的电源是关闭的, 和所有设备都已正确安装。电源插座有防呆设计, 确认正确的方向后插入即可。

12V电源插座主要是提供CPU电源, 若没有接上12V电源插座, 系统将不会启动。

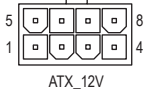


为因应扩充需求, 建议您使用输出功率大的电源供应器(500瓦或以上), 以供应足够的电力需求。若使用电力不足的电源供应器, 可能会导致系统不稳或无法开机。



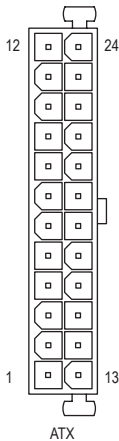
ATX_12V1:

接脚	定义
1	接地脚
2	接地脚
3	+12V
4	+12V



ATX_12V:

接脚	定义	接脚	定义
1	接地脚 (仅供 8PIN 的电源接口使用)	5	+12V (仅供 8PIN 的电源接口使用)
2	接地脚 (仅供 8PIN 的电源接口使用)	6	+12V (仅供 8PIN 的电源接口使用)
3	接地脚	7	+12V
4	接地脚	8	+12V

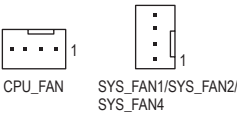


ATX:

接脚	定义	接脚	定义
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	接地脚	15	接地脚
4	+5V	16	PS_ON (soft On/Off)
5	接地脚	17	接地脚
6	+5V	18	接地脚
7	接地脚	19	接地脚
8	Power Good	20	无作用
9	5VSB (stand by +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V (仅供 24PIN 的电源接口使用)	23	+5V (仅供 24PIN 的电源接口使用)
12	3.3V (仅供 24PIN 的电源接口使用)	24	接地脚 (仅供 24PIN 的电源接口使用)

3/4) CPU_FAN/SYS_FAN1/2/4 (散热风扇插座)

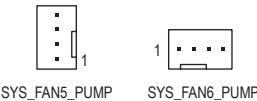
此主板的散热风扇插座都为4-pin。这些插座都有防呆设计, 安装时请注意方向(黑色线为接地线)。若要使用风扇控制功能, 须搭配具有转速控制设计的散热风扇才能使用此功能。建议您于机箱内加装系统散热风扇, 以达到上佳的散热性能。



接脚	定义
1	接地脚
2	电压速度控制脚
3	转速检测脚
4	脉宽调变速度控制脚

5) SYS_FAN5_PUMP/SYS_FAN6_PUMP (系统风扇/水泵插座)

这些风扇/水泵插座为4-pin。这些插座都有防呆设计, 安装时请注意方向(黑色线为接地线)。若要使用风扇控制功能, 须搭配具有转速控制设计的散热风扇才能使用此功能。建议您于机箱内加装系统散热风扇, 以达到上佳的散热性能。此插座亦可提供水泵调整转速的功能, 详细设置请参考第二章「BIOS程序设置」-「Settings\Smart Fan 5」的说明)。



接脚	定义
1	接地脚
2	电压速度控制脚
3	转速检测脚
4	脉宽调变速度控制脚

6) CPU_OPT (CPU水冷风扇插座)

此水冷风扇插座为4-pin。此插座有防呆设计, 安装时请注意方向(黑色线为接地线)。若要使用风扇控制功能, 须搭配具有转速控制设计的散热风扇才能使用此功能。



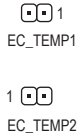
接脚	定义
1	接地脚
2	电压速度控制脚
3	转速检测脚
4	脉宽调变速度控制脚



- 请务必接上散热风扇的插座, 以避免CPU及系统处于过热的工作环境, 若温度过高可能导致CPU或是系统死机。
- 这些散热风扇插座并非跳线, 请勿放置跳帽在针脚上。

7) EC_TEMP1/EC_TEMP2 (感温线针脚)

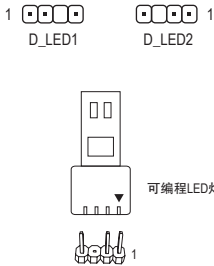
这些针脚可连接感温线, 提供温度检测的功能。



接脚	定义
1	SENSOR IN
2	接地线

8) D_LED1/D_LED2 (可编程LED灯带电源插座)

这些插座可连接标准5050可编程LED灯带, 最大供电是5安培(5伏特), 长度限制为5m或LED数目1000颗以内的灯带。

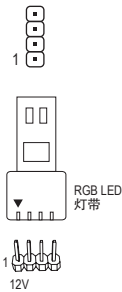


接脚	定义
1	V (5V)
2	D
3	无接脚
4	G

请将可编程LED灯带接至此插座。安装时请将灯带的电源接脚(接口上三角形标示)连接至插座的接脚1, 不正确安装将会造成灯带烧毁。

9) LED_CPU (散热风扇灯带/RGB LED灯带电源插座)

此插座可连接散热风扇灯带或标准5050 RGB LED灯带(12V/G/R/B), 最大供电是2安培(12伏特), 长度限制为2m。



接脚	定义
1	12V
2	G
3	R
4	B

请将散热风扇灯带或RGB LED灯带接至此插座。安装时请将灯带的电源接脚(接口上三角形标示)连接至插座的接脚1(12V), 不正确安装将会造成灯带烧毁。



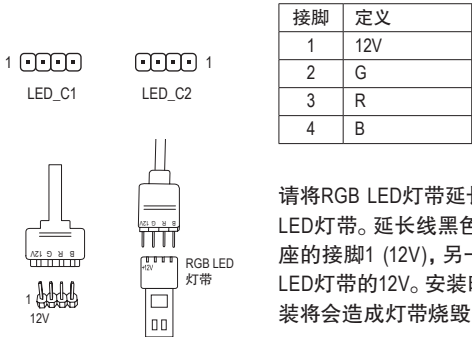
有关灯带的控制功能请至技嘉网站查询产品功能的介绍说明。



安装前, 请务必将设备及电脑的电源关闭, 并将电源线自插座中拔除, 以免造成设备的损毁。

10) LED_C1/LED_C2 (RGB LED灯带电源插座)

这些插座可连接标准5050 RGB LED灯带(12V/G/R/B)，最大供电是2安培(12伏特)，长度限制为2m。



请将RGB LED灯带延长线接口接至此插座，另一端接至RGB LED灯带。延长线黑色线(接口上三角形标示)需连接至此插座的接脚1 (12V)，另一端的12V (接口上箭头标示)需连接至LED灯带的12V。安装时务必注意LED灯带的插法，不正确安装将会造成灯带烧毁。



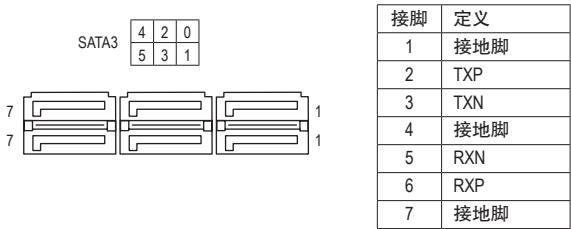
有关灯带的控制功能请至技嘉网站查询产品功能的介绍说明。



安装前，请务必将设备及电脑的电源关闭，并将电源线自插座中拔除，以免造成设备的损毁。

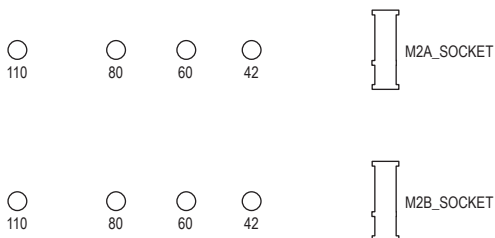
11) SATA3 0/1/2/3/4/5 (SATA 3.0接口)

这些SATA接口支持SATA 3.0规格，并可兼容于SATA 2.0及SATA 1.0规格。一个SATA接口只能连接一个SATA设备，可以构建RAID 0、RAID 1及RAID 10磁盘阵列，若您要构建RAID，请参考第三章-「构建磁盘阵列」的说明。



12) M2A_SOCKET/M2B_SOCKET (M.2 SSD插槽)

M.2插槽可以支持M.2 SATA SSD或M.2 PCIe SSD, 并可以构建RAID磁盘阵列。请注意, 若安装的是M.2 PCIe SSD, 无法与其它M.2 SATA SSD或是SATA硬盘共同构建磁盘阵列。若您要构建RAID, 请参考第三章-「构建磁盘阵列」的说明。



请依下列步骤将M.2 SSD正确地安装于M.2插座。

步骤一：

请先从随货附赠的M.2螺丝包/螺柱包中找出一组螺柱及螺丝。确认要安装M.2 SSD的M.2插槽后, 将散热片以螺丝起子卸下螺丝后移除。

步骤二：

依实际要安装的M.2 SSD规格找到适合螺丝孔位的后, 先锁上螺柱, 将M.2 SSD以斜角方式放入插槽。

步骤三：

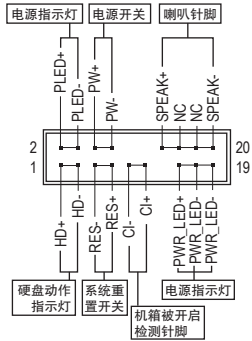
压住M.2 SSD的后, 再将螺丝锁上。最后将散热片锁回原本的孔位。



请依实际安装的M.2 SSD规格调整螺丝和螺柱的位置。

13) F_PANEL (主板跳线插座)

电脑机箱的电源开关、系统重置开关、喇叭、机箱被开启检测开关/感应器及系统运行指示灯等可以接至此插座。请依据下列的针脚定义连接，连接时请注意针脚的正负(+/-)极。



- **PLED/PWR_LED – 电源指示灯:**

系统状态	灯号
S0	灯亮
S3/S4/S5	灯灭

连接至机箱前方面板的电源指示灯。当系统正在运行时，指示灯为持续亮着；系统进入休眠模式(S3/S4)及关机(S5)时，则为熄灭。
- **PW – 电源开关:**连接至电脑机箱前方面板的主电源开关键。您可以在BIOS程序中设置此按键的关机方式(请参考第二章「BIOS程序设置」-「Settings\Platform Power」的说明)。
- **SPEAK – 喇叭针脚:**连接至电脑机箱前方面板的喇叭。系统会以不同的哔声来反应目前的开机状况，通常正常开机时，会有一哔声。

- **HD – 硬盘动作指示灯:**连接至电脑机箱前方面板的硬盘动作指示灯。当硬盘有存取动作时指示灯即会亮起。
- **RES – 系统重置开关:**连接至电脑机箱前方面板的重置开关(Reset)键。在系统死机而无法正常重新启动时，可以按下重置开关键来重新启动系统。
- **CL – 电脑机箱被开启检测针脚:**连接至电脑机箱的机箱被开启检测开关/感应器，以检测机箱是否曾被开启。若要使用此功能，需搭配具有此设计的电脑机箱。
- **NC: 无作用。**



电脑机箱的前方控制面板设计会因不同机箱而有不同，主要包括电源开关、系统重置开关、电源指示灯、硬盘动作指示灯、喇叭等，请依机箱上的信号线连接。

14) F_AUDIO (前置音频插座)

此前置音频插座支持HD (High Definition, 高保真)。您可以连接机箱前方面板的音频模块至此插座，安装前请先确认音频模块的接脚定义是否与插座吻合，若安装不当可能造成设备无法使用甚至损毁。



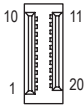
接脚	定义	接脚	定义
1	MIC2_L	6	检测
2	接地脚	7	FAUDIO_JD
3	MIC2_R	8	无接脚
4	无作用	9	LINE2_L
5	LINE2_R	10	检测



电脑机箱的前方控制面板设计会因不同机箱而有不同，主要包括电源开关、系统重置开关、电源指示灯、硬盘动作指示灯、喇叭等，请依机箱上的信号线连接。

15) F_USB31C (USB Type-C™接口扩充插座, 支持USB 3.2 Gen 2)

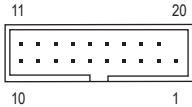
此插座支持USB 3.2 Gen 2规格并可接出一个USB接口。



接脚	定义	接脚	定义	接脚	定义
1	VBUS	8	CC1	15	RX2+
2	TX1+	9	SBU1	16	RX2-
3	TX1-	10	SBU2	17	接地脚
4	接地脚	11	VBUS	18	D-
5	RX1+	12	TX2+	19	D+
6	RX1-	13	TX2-	20	CC2
7	VBUS	14	接地脚		

16) F_USB30_1/F_USB30_2 (USB 3.2 Gen 1接口扩充插座)

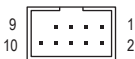
这些插座支持USB 3.2 Gen 1/USB 2.0规格，一个插座可以接出两个USB接口。若要选购内含2个USB 3.2 Gen 1接口的3.5寸前置扩充面板，您可以联系当地代理商购买。



接脚	定义	接脚	定义	接脚	定义
1	VBUS	8	D1-	15	SSTX2-
2	SSRX1-	9	D1+	16	接地脚
3	SSRX1+	10	无作用	17	SSRX2+
4	接地脚	11	D2+	18	SSRX2-
5	SSTX1-	12	D2-	19	VBUS
6	SSTX1+	13	接地脚	20	无接脚
7	接地脚	14	SSTX2+		

17) F_USB1/F_USB2 (USB 2.0/1.1接口扩充插座)

这些插座支持USB 2.0/1.1规格，通过USB扩充挡板，一个插座可以接出两个USB接口。USB扩充挡板为选购配件，您可以联系当地代理商购买。



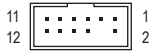
接脚	定义	接脚	定义
1	电源 (5V)	6	USB DY+
2	电源 (5V)	7	接地脚
3	USB DX-	8	接地脚
4	USB DY-	9	无接脚
5	USB DX+	10	无作用



- 请勿将2x5-pin的IEEE 1394扩充挡板连接至USB 2.0/1.1接口扩充插座。
- 连接USB扩充挡板前，请务必将电脑的电源关闭，并将电源线自插座中拔除，以免造成USB扩充挡板的损毁。

18) TPM (安全加密模块连接插座)

您可以连接TPM (Trusted Platform Module)安全加密模块至此插座。



接脚	定义	接脚	定义
1	LAD0	7	LAD3
2	VCC3	8	接地脚
3	LAD1	9	LFRAME
4	无接脚	10	无作用
5	LAD2	11	SERIRQ
6	LCLK	12	LRESET

19) CLR_CMOS (清除CMOS数据跳线)

利用此跳线可以将主板的BIOS设置数据清除，回到出厂设置值。如果您要清除CMOS数据时，请使用如螺丝起子的类的金属物同时碰触两支跳线数秒钟。



开路：一般运行



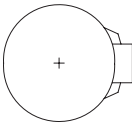
短路：清除 CMOS 数据



- 清除CMOS数据前，请务必关闭电脑的电源并拔除电源线。
- 开机后请进入BIOS载入出厂预设值(Load Optimized Defaults)或自行输入设置值(请参考第二章－「BIOS程序设置」的说明)。

20) BAT (电池)

此电池提供电脑系统于关闭电源后仍能储存CMOS数据(例如：日期及BIOS设置)所需的电力，当此电池的电力不足时，会造成CMOS的数据错误或遗失，因此当电池电力不足时必须更换。



您也可以利用拔除电池来清除CMOS数据：

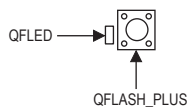
- 请先关闭电脑，并拔除电源线。
- 小心地将电池从电池座中取出，等候约一分钟。(或是使用如螺丝起子的类的金属物碰触电池座的正负极，造成其短路约五秒钟)
- 再将电池装回。
- 接上电源线并重新开机。



- 更换电池前，请务必关闭电脑的电源并拔除电源线。
- 更换电池时请更换相同型号的电池，不正确的型号可能引起配备的损毁。
- 若无法自行更换电池或不确定电池型号时，请联系购买店家或代理商。
- 安装电池时，请注意电池上的正(+)负(-)极(正极须向上)。
- 更换下来的旧电池须依当地法规处理。

21) QFLASH_PLUS (Q-Flash Plus按钮)

Q-Flash Plus提供您于系统关机(S5待机模式)状态下更新BIOS, 通过连接至特定接口的U盘, 按下Q-Flash Plus按钮即会启动并载入数据修复。运行时QFLED会开始闪烁(表示开始进行比对), QFLED闪烁停止时代表主BIOS更新结束。



有关Q-Flash Plus功能请至技嘉网站查产品功能的介绍说明。

22) CPU/DRAM/VGA/BOOT (状态指示灯)

状态指示灯可以显示开机后CPU、内存、显卡及操作系统的状态是否正常。CPU、DRAM及VGA灯号亮起时表示设备有异常; BOOT灯号亮起则表示未进入操作系统。

□ □		CPU: CPU 状态指示灯	
□ □		DRAM: 内存状态指示灯	
CPU	DRAM	VGA: 显卡状态指示灯	
VGA	BOOT	BOOT: 操作系统状态指示灯	

第二章 BIOS 程序设置

BIOS (Basic Input and Output System, 基本输入输出系统)经由主板上的CMOS芯片,记录着系统各项硬件设备的设置参数。主要功能为开机自我测试(POST, Power-On Self-Test)、保存系统设置值及载入操作系统等。BIOS包含了BIOS设置程序,供用户依照需求自行设置系统参数,使电脑正常工作或执行特定的功能。

储存CMOS数据所需的电力由主板上的锂电池供应,因此当系统电源关闭时,这些数据并不会遗失,当下次再开启电源时,系统便能读取这些设置数据。

若要进入BIOS设置程序,电源开启后,BIOS在进行POST时,按下<Delete>键便可进入BIOS设置程序主画面。

当您需要更新BIOS,可以使用技嘉特有的BIOS更新方法: Q-Flash或@BIOS。

- Q-Flash 是可在BIOS设置程序内更新BIOS的软件,让用户不需进入操作系统,就可以轻松的更新或备份BIOS。
- @BIOS 是可在Windows操作系统内更新BIOS的软件,通过与互联网的连接,下载及更新最新版本的BIOS。

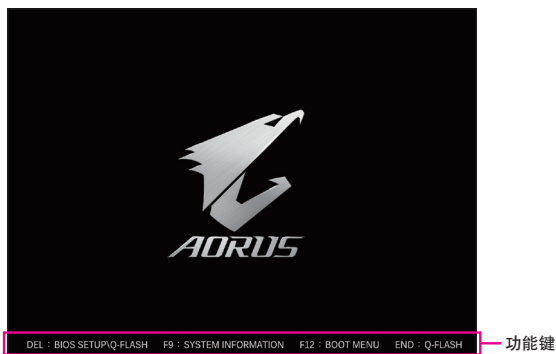


- 更新BIOS有其潜在的风险,如果您使用目前版本的BIOS没有问题,我们建议您不要任意更新BIOS。如需更新BIOS,请小心的执行,以避免不当的操作而造成系统损毁。
- 我们不建议您随意变更BIOS设置程序的设置值,因为可能因此造成系统不稳定或其它不可预期的结果。如果因设置错误造成系统不稳定或不开机时,请试着清除CMOS设置值数据,将BIOS设置恢复至出厂预设值。(清除CMOS设置值,请参考第二章 – 「Load Optimized Defaults」的说明,或是参考第一章 – 「电池」或「CLR_CMOS跳线」的说明。)

2-1 开机画面

电源开启后,会看到如以下的开机Logo画面:

(BIOS范例版本: E2)



BIOS设置程序画面分为以下两种模式,您可使用<F2>键切换至不同模式:

Easy Mode让用户可以快速地浏览主要系统信息或优化系统性能,您可以使用鼠标点选不同功能做快速设置。Advanced Mode提供详细的BIOS设置选项,在此画面中,您可以使用键盘上下左右键来选择要设置的选项,按<Enter>键即可进入子选单,也可以使用鼠标选择所要的选项。



- 若系统运行不稳定时,请选择「Load Optimized Defaults」,即可载入出厂的预设值。
- 实际的BIOS设置画面可能会因不同的BIOS版本而有差异,本章节的BIOS设置程序画面仅供参考。

2-2 BIOS 设置程序主画面



Advanced Mode 操作按键

<←><→>	向左或向右移动光标选择功能选单
<↑><↓>	向上或向下移动光标选择设置项目
<Enter>/Double Click	确定选项设置值或进入功能选单
<+>/<Page Up>	改变设置状态, 或增加栏位中的数值
<->/<Page Down>	改变设置状态, 或减少栏位中的数值
<F1>	显示所有功能键的相关说明
<F2>	切换至 Easy Mode
<F3>	可将设置好的 BIOS 设置值储存成一个 CMOS 设置文件 (Profile)
<F4>	可将预存的 CMOS 设置文件载入
<F5>	可载入该画面原先所有项目设置 (仅适用于子选单)
<F6>	显示 Smart Fan 5 设置画面
<F7>	可载入该画面的最佳化预设值 (仅适用于子选单)
<F8>	进入 Q-Flash 画面
<F10>	是否储存设置并离开 BIOS 设置程序
<F11>	切换至我的最爱设置页
<F12>	截取目前画面, 并自动存至 U 盘
<Insert>	可增加或删除最爱设置
<Ctrl>+<S>	显示所安装的内存信息
<Esc>	离开目前画面, 或从主画面离开 BIOS 设置程序

2-3 Favorites (F11) (最爱设置)



您可以将经常使用的选项设为最爱，并可利用功能键<F11>快速切换至此页面，以利变更其设置。在各选项所属页面中，按<Insert>键即可增加或删除最爱设置，被设为最爱的选项会以星号表示。

2-4 Tweaker (频率 / 电压控制)



系统是否会依据您所设置的超频或超电压值稳定运行，需视整体系统配备而定。不当的超频或超电压可能会造成CPU、芯片组及内存的损毁或减少其使用寿命。我们不建议您随意调整此页的选项，因为可能造成系统不稳或其它不可预期的结果。仅供电脑玩家使用。(若自行设置错误，可能会造成系统不开机，您可以清除CMOS设置值数据，让BIOS设置恢复至预设值。)

🔑 CPU Clock Control (CPU频率控制)

此选项提供您一次以1 MHz为单位调整CPU的基频。(预设值: Auto)

强烈建议您依照处理器规格来调整处理器的频率。

🔑 CPU Clock Ratio (CPU倍频调整)

此选项提供您调整CPU的倍频，可调整范围会依CPU种类自动检测。

■ Advanced CPU Settings

🔑 Core Performance Boost^(注)

此选项提供您选择是否启动CPU的Core Performance Boost模式(CPB, CPU加速模式)。(预设值: Auto)

🔑 SVM Mode (虚拟化技术)

此选项提供您选择是否启动虚拟化技术。虚拟化技术让您可以在同一平台的独立数据分割区，执行多个操作系统和应用程序。(预设值: Disabled)

🔑 Global C-state Control^(注)

此选项提供您选择是否让CPU进入C-state省电模式。启动此选项可以让系统在闲置状态时，降低CPU时脉，以减少耗电量。(预设值: Enabled)

🔑 Power Supply Idle Control^(注)

此选项提供您关闭或开启Package C6 State。

▶▶ Typical Current Idle 关闭此功能。

▶▶ Low Current Idle 开启此功能。

▶▶ Auto BIOS会自动设置此功能。(预设值)

🔑 AMD CPU fTPM

此选项提供您选择是否要开启AMD CPU内建的TPM 2.0功能。(预设值: Disabled)

🔑 IOMMU^(注)

此选项提供您选择是否开启AMD IOMMU功能。(预设值: Auto)

(注) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU。

☞ **Extreme Memory Profile (X.M.P.)** (注一)

开启此选项BIOS可读取XMP规格内存模块的SPD数据,可强化内存性能。

- Disabled 关闭此功能。(预设值)
- Profile1 设置组合一。
- Profile2 (注一) 设置组合二。

☞ **System Memory Multiplier (内存倍频调整)**

此选项提供您调整内存的倍频。若设为「Auto」, BIOS将依内存SPD数据自动设置。

(预设值: Auto)

■ **Advanced Memory Settings**

☞ **Memory Timing Mode**

当此选项被设为「Manual」时,「Memory Subtimings」的内存时序调整设置选项将开放为可手动调整。选项包括: Auto (预设值)及Manual。

☞ **CLDO_VDDP Control** (注二)

此选项提供您选择是否开启手动调整CLDO_VDDP电压功能。若设为「Auto」, BIOS会自动设置此功能。(预设值: Auto)

☞ **CLDO_VDDP Voltage(mV)** (注二)

此选项可让您手动调整CLDO_VDDP电压。此选项只有在「CLDO_VDDP Control」设为「Manual」时,才能开放设置。

■ **SPD Info**

此选项显示所安装的内存信息。

■ **Memory Subtimings**

▼ **Standard Timing Control, Advanced Timing Control, CAD Bus Setup Timing, CAD Bus Drive Strength, Data Bus Configuration**

这些选项可让您调整内存的时序, 这些选项只有在「Memory Timing Mode」设为「Manual」, 才能开放设置。请注意! 在您调整完内存时序后, 可能会发生系统不稳或不开机的情况, 您可以载入最佳化设置或清除CMOS设置值数据, 让BIOS设置恢复至预设值。

☞ **CPU Vcore/Dynamic Vcore(DVID)/VCORE SOC/Dynamic VCORE SOC(DVID)/CPU VDD18/CPU VDDP/PM_1VSOC/PM_1V8/DRAM Voltage (CH A/B)**

这些选项可让您调整CPU Vcore及内存的电压值。

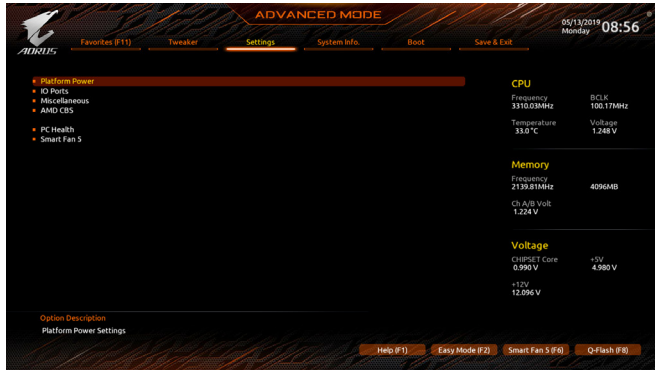
■ **Advanced Voltage Settings**

此画面可让您调整Load-Line Calibration幅度、过电压保护值、过电流保护值、PWM工作频率...等设置。

(注一) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU及内存模块。

(注二) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU。

2-5 Settings (设置)



■ Platform Power

☞ AC BACK (电源中断后, 电源回复时的系统状态选择)

此选项提供您选择断电后电源回复时的系统状态。

- ▶▶ Memory 断电后电源回复时, 系统将恢复至断电前的状态。
- ▶▶ Always On 断电后电源回复时, 系统将立即被启动。
- ▶▶ Always Off 断电后电源回复时, 系统维持关机状态, 需按电源键才能重新启动系统。(预设值)

☞ ErP

此选项提供您选择是否在系统关机(S5待机模式)时将耗电量调整至最低。(预设值: Disabled)
请注意: 当启动此功能后, 以下功能将无作用: 定时开机功能、鼠标开机功能及键盘开机功能。

☞ Soft-Off by PWR-BTTN (关机方式)

此选项提供您选择在MS-DOS系统下, 使用电源键的关机方式。

- ▶▶ Instant-Off 按一下电源键即可立即关闭系统电源。(预设值)
- ▶▶ Delay 4 Sec. 需按住电源键4秒后才会关闭电源。若按住时间少于4秒, 系统会进入暂停模式。

☞ Power Loading

此选项提供您选择是否开启或关闭虚拟负载。当您的电源供应器因为负载过低造成断电或死机的保护现象, 请设置为「Enabled」。若设为「Auto」, BIOS会自动设置此功能。(预设值: Auto)

☞ Resume by Alarm (定时开机)

此选项提供您选择是否允许系统在特定的时间自动开机。(预设值: Disabled)
若启动定时开机, 则可设置以下时间:

- ▶▶ Wake up day: 0 (每天定时开机), 1~31 (每个月第几天定时开机)
- ▶▶ Wake up hour/minute/second: (0~23) : (0~59) : (0~59) (定时开机时间)

请注意: 使用定时开机功能时, 请避免在操作系统中不正常的关机或中断总电源。

☞ Wake on LAN (网络开机功能)

此选项提供您选择是否使用网络开机功能。(预设值: Enabled)

☞ High Precision Event Timer

此选项提供您选择是否在操作系统下开启High Precision Event Timer (HPET, 高精度事件计时器)的功能。(预设值: Enabled)

☞ CEC 2019 Ready

此选项提供您选择是否在系统关机、闲置和待机模式时调整其用电量设置, 以符合CEC2019规范(California Energy Commission Standards 2019)。(预设值: Disabled)

■ IO Ports

🔍 Integrated Graphics (集成显示功能)^(注)

此选项提供您选择是否开启主板集成的显示功能。

- ▶ Auto BIOS会依所安装的显卡自动开启或关闭主板集成的显示功能。(预设值)
- ▶ Forces 开启主板集成的显示功能。
- ▶ Disabled 关闭主板集成的显示功能。

🔍 UMA Mode^(注)

此选项提供您设置UMA模式。

- ▶ Auto BIOS会自动设置此功能。(预设值)
- ▶ UMA Specified 设置显示内存大小。
- ▶ UMA Auto 设置显示分辨率。

此选项只有在「Integrated Graphics」设为「Forces」时，才能开放设置。

🔍 UMA Frame Buffer Size (选择显示内存大小)^(注)

UMA Frame Buffer Size指的是主板集成显示功能所需要的显示内存大小。此部份的显示内存由系统主内存分享出来。例如像MS-DOS操作系统就会使用到这一部份的内存来做为显示的用。选项包括: Auto (预设值)、64M~16G。

此选项只有在「UMA Mode」设为「UMA Specified」时，才能开放设置。

🔍 Display Resolution (选择分辨率)^(注)

此选项提供您选择分辨率。选项包括: Auto (预设值)、1920x1080 and below、2560x1600、3840x2160。

此选项只有在「UMA Mode」设为「UMA Auto」时，才能开放设置。

🔍 Initial Display Output

此选项提供您选择系统开机时优先从集成显示功能或PCI-E显卡输出。

- ▶ IGD Video^(注) 系统会从集成显示功能输出。
- ▶ PCIe 1 Slot 系统会从安装于PCIEX16插槽上的显卡输出。(预设值)
- ▶ PCIe 2 Slot 系统会从安装于PCIEX8插槽上的显卡输出。
- ▶ PCIe 3 Slot^(注) 系统会从安装于PCIEX4插槽上的显卡输出。

🔍 HD Audio Controller (集成音频功能)

此选项提供您选择是否开启主板集成的音频功能。(预设值: Enabled)

若您想安装其他厂商的声卡时，请先将此选项设为「Disabled」。

🔍 PCIEX16 Bifurcation

此选项提供您选择设置PCIEX16插槽的分流模式，选项有: Auto、PCI-E 2x8、PCI-E 1x8/2x4、PCI-E 4x4。(预设值: Auto)

🔍 Above 4G Decoding

此选项提供您针对64位的设备开启或关闭4 GB以上的内存空间。外接多张高阶显卡时，因为4 GB以下内存空间不足，造成进入操作系统时无法启动驱动程序，可启动此功能。此功能只用在64位操作系统。(预设值: Disabled)

🔍 Onboard LAN Controller (集成网络功能)

此选项提供您选择是否开启主板集成的网络功能。(预设值: Enabled)

若您想安装其他厂商的网络卡时，请先将此选项设为「Disabled」。

🔍 NVMe RAID mode

此选项提供您是否使用M.2 NVMe PCIe SSD构建RAID模式。(预设值: Disabled)

(注) 此选项仅开放给有支持此功能的CPU。

■ USB Configuration

☞ Legacy USB Support (支持USB规格键盘/鼠标)

此选项提供您选择是否在MS-DOS操作系统下使用USB键盘或鼠标。(预设值: Enabled)

☞ XHCI Hand-off (XHCI Hand-off功能)

此选项提供您选择是否针对不支持XHCI Hand-off功能的操作系统, 强制开启此功能。
(预设值: Enabled)

☞ USB Mass Storage Driver Support (USB储存设备支持)

此选项提供您选择是否支持USB储存设备。(预设值: Enabled)

☞ Port 60/64 Emulation (I/O接口60/64h的模拟支持)

此选项提供您选择是否开启对 I/O接口60/64h的模拟支持。开启此功能可让没有原生支持USB的操作系统可以完全地支持 USB 键盘。(预设值: Disabled)

☞ Mass Storage Devices (USB储存设备设置)

此选项列出您所连接的USB储存设备清单, 此选项只有在连接USB储存设备时, 才会出现。

■ NVMe Configuration

此选项列出您所连接的M.2 NVME PCIe SSD设备相关信息。

■ SATA Configuration

☞ SATA Mode

此选项提供您选择是否开启芯片组内建SATA控制器的RAID功能。

» RAID 开启SATA控制器的RAID功能。

» AHCI 设置SATA控制器为AHCI模式。AHCI (Advanced Host Controller Interface)为一种介面规格, 可以让储存驱动程序启动进阶Serial ATA功能, 例: Native Command Queuing 及热插拔(Hot Plug)等。(预设值)

☞ SATA Port 0/1/2/3/4/5 (SATA3 0、1、2、3、4、5插座)

此选项列出您所连接的SATA设备信息。

■ Miscellaneous

☞ LEDs in System Power On State

此选项提供您选择当系统开机时是否开启主板灯号的显示模式。

» Off 当系统开机时, 将会关闭您所设置的灯号模式。

» On 当系统开机时, 将会开启您所设置的灯号模式。(预设值)

☞ LEDs in Sleep, Hibernation, and Soft Off States

此选项提供您选择当系统进入S3/S4/S5模式时是否开启主板灯号的显示模式。

此选项只有在「LEDs in System Power On State」设为「On」时, 才能开启此功能。

» Off 当系统进入S3/S4/S5模式时, 将会关闭您所设置的灯号模式。(预设值)

» On 当系统进入S3/S4/S5模式时, 将会开启您所设置的灯号模式。

■ Trusted Computing

此选项提供您选择是否开启安全加密模块(TPM)功能。

☞ PCIe Slot Configuration

此选项提供您选择设置PCI Express插槽要以Gen 1、Gen 2、Gen 3或Gen 4模式运行。实际运行模式仍需以各插槽的规格为主。若设为「Auto」, BIOS会自动设置此功能。(预设值: Auto)

☞ 3DMark01 Enhancement

此选项提供您选择是否强化对早期硬件测试软件的测试性能。(预设值: Disabled)

■ AMD CBS

此画面提供AMD CBS相关设置。

■ PC Health

☞ Reset Case Open Status (重置机箱状况)

- ▶ Disabled 保留之前机箱被开启状况的记录。(预设值)
- ▶ Enabled 清除之前机箱被开启状况的记录。

☞ Case Open (机箱被开启状况)

此栏位显示主板上的「CI针脚」通过机箱上的检测设备所检测到的机箱被开启状况。如果电脑机箱未被开启,此栏位会显示「NO」;如果电脑机箱被开启过,此栏位则显示「YES」。如果您希望清除先前机箱被开启状况的记录,请将「Reset Case Open Status」设为「Enabled」并重新开机即可。

☞ CPU Vcore/CPU VDDP/CPU VDD18/DDRvtt A/B/DRAM Channel A/B Voltage/PM_CLDO12/ +3.3V/+5V/CHIPSET Core/+12V/VCORE SOC (检测系统电压)

显示系统目前的各电压值。

■ Smart Fan 5

☞ Monitor (监控)

此选项提供您选择要监控及设置的对象。(预设值: CPU FAN)

☞ Fan Speed Control (智能风扇转速控制)

此选项提供您选择是否启动智能风扇转速控制功能,并可以调整风扇运转速度。

- ▶ Normal 风扇转速会依温度而有所不同,并可视个人的需求,在System Information Viewer中调整适当的风扇转速。(预设值)
- ▶ Silent 风扇将以低速运行。
- ▶ Manual 您可以在曲线图中调整风扇的转速。
- ▶ Full Speed 风扇将以全速运行。

☞ Fan Control Use Temperature Input (参考温度来源选择)

此选项提供您选择控制风扇转速的参考温度来源。

☞ Temperature Interval (缓冲温度)

此选项提供您选择风扇转速的反应缓冲温度。

☞ Fan/Pump Control Mode (智能风扇/水泵控制模式)

- ▶ Auto 自动设置成上佳控制方式。(预设值)
- ▶ Voltage 使用3-pin的风扇/水泵时建议选择Voltage模式。
- ▶ PWM 使用4-pin的风扇/水泵时建议选择PWM模式。

☞ Fan/Pump Stop (风扇/水泵停止运转)

此选项提供您选择是否启动风扇/水泵停止运转的功能。您可以在曲线图内设置温度的上限,当温度低于上限时风扇/水泵将会停止运转。(预设值: Disabled)

☞ Temperature (检测温度)

显示您所监控的对象目前温度。

☞ Fan Speed (检测风扇/水泵转速)

显示风扇/水泵目前的转速。

☞ Flow Rate (检测水冷系统流速)

显示水冷系统目前的流速。

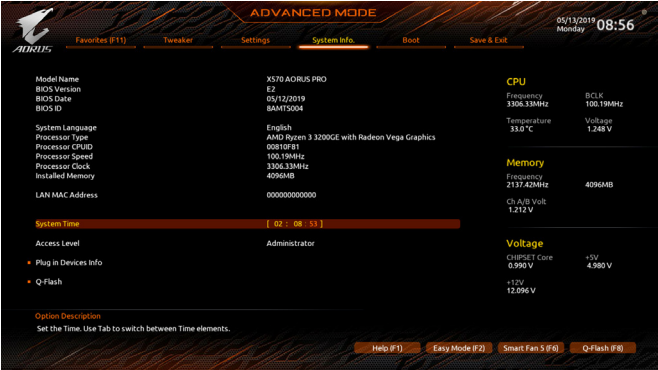
☞ **Temperature Warning (温度警告)**

此选项提供您选择设置过温警告的温度。当温度超过此选项所设置的数值时，系统将会发出警告声。选项包括：Disabled (预设值，关闭温度警告)、60°C/140°F、70°C/158°F、80°C/176°F、90°C/194°F。

☞ **Fan/Pump Fail Warning (风扇/水泵故障警告功能)**

此选项提供您选择是否启动风扇/水泵故障警告功能。启动此选项后，当风扇/水泵没有接上或故障的时候，系统将会发出警告声。此时请检查风扇/水泵的连接或运行状况。
(预设值：Disabled)

2-6 System Info. (系统信息)



此画面提供您主板型号及BIOS 版本等信息。您可以选择BIOS设置程序所要使用的语言或是设置系统时间。

System Language (设置使用语言)

此选项提供您选择BIOS设置程序内所使用的语言。

System Time (时间设置) (注)

设置电脑系统的时间，格式为「时: 分: 秒」。例如下午一点显示为「13: 00: 00」。若要切换至「时」、「分」、「秒」栏位，可使用<Enter>键，并使用键盘<Page Up>或<Page Down>键切换至所要的数值。

Access Level (使用权限)

依登入的密码显示目前用户的权限（若没有设置密码，将显示「Administrator」。管理员 (Administrator) 权限允许您修改所有BIOS设置。用户 (User) 权限仅允许修改部份您BIOS设置。

Plug in Devices Info

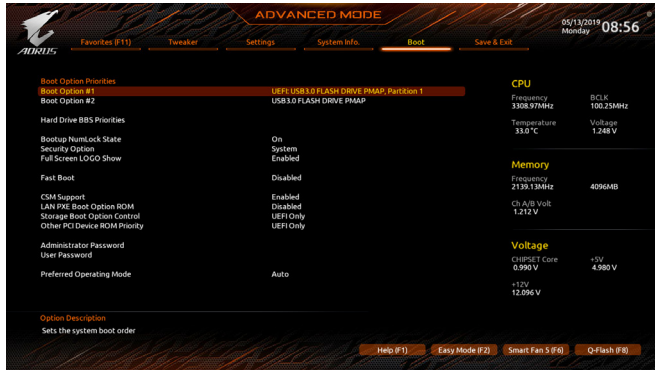
此选项列出您所连接的SATA、PCI Express、M.2…等设备相关信息。

Q-Flash

此选项可以进入Q-Flash程序，以进行更新BIOS (Update BIOS)或备份目前的BIOS文件(Save BIOS)。

(注) 若要调整日期，请以鼠标点选右上角齿轮图示进入调整。

2-7 Boot (开机功能设置)



Boot Option Priorities (开机设备顺序设置)

此选项提供您从已连接的设备中设置开机顺序，系统会依此顺序进行开机。当您安装的是支持GPT格式的可卸除式储存设备时，该设备前方会注明"UEFI"，若您想由支持GPT磁盘分割的系统开机时，可选择注明"UEFI"的设备开机。

若您想安装支持GPT格式的操作系統，例如Windows 10 64-bit，请选择存放Windows 10 64-bit 安装光盘并注明为"UEFI"的光驱开机。

Hard Drive/CD/DVD ROM Drive/Floppy Drive/Network Device BBS Priorities (各类设备开机顺序设置)

此选项提供您设置各类型设备(包含硬盘、光驱、软盘机及支持网络开机的设备)的开机顺序。在项目按<Enter>键可进入该类型设备的子选单，子选单会列出所有已安装设备。此选项只有在最少安装一组设备时才会出现。

Bootup NumLock State (开机时Num Lock键状态)

此选项提供您设置开机时键盘上<Num Lock>键的状态。(预设值: On)

Security Option (检查密码方式)

此选项提供您选择是否在每次开机时都需输入密码，或仅在进入BIOS设置程序时才需输入密码。设置完此选项后请至「Administrator Password/User Password」选项设置密码。

▶▶ Setup 仅在进入BIOS设置程序时才需输入密码。

▶▶ System 无论是开机或进入BIOS设置程序均需输入密码。(预设值)

Full Screen LOGO Show (显示开机画面功能)

此选项提供您选择是否在一开机时显示技嘉Logo。若设为「Disabled」，开机时将不显示Logo。(预设值: Enabled)

Fast Boot

此选项提供您是否启动快速开机功能以缩短进入操作系统的时间。若设为「Ultra Fast」可以提供最快速的开机功能。(预设值: Disabled)

SATA Support

▶▶ Last Boot SATA Devices Only 关闭除了前次开机硬盘以外的所有SATA设备至操作系统启动完成。(预设值)

▶▶ All SATA Devices 在操作系统下及开机自我测试(POST)过程中，所有SATA设备都可使用。此选项只有在「Fast Boot」设为「Enabled」或「Ultra Fast」时，才能开放设置。

🔑 NVMe Support

此选项提供您选择是否开启支持NVMe设备。(预设值: Enabled)

此选项只有在「Fast Boot」设为「Enabled」或「Ultra Fast」时,才能开放设置。

🔑 VGA Support

此选项提供您选择支持何种操作系统开机。

» Auto 仅启动Legacy Option ROM。

» EFI Driver 启动EFI Option ROM。(预设值)

此选项只有在「Fast Boot」设为「Enabled」或「Ultra Fast」时,才能开放设置。

🔑 USB Support

» Disabled 关闭所有USB设备至操作系统启动完成。

» Full Initial 在操作系统下及开机自我测试(POST)过程中,所有USB设备都可使用。
(预设值)

» Partial Initial 关闭部分USB设备至操作系统启动完成。

此选项只有在「Fast Boot」设为「Enabled」时,才能开放设置。当「Fast Boot」设为「Ultra Fast」时,此功能会被强制关闭。

🔑 NetWork Stack Driver Support

» Disabled 关闭网络开机功能支持。(预设值)

» Enabled 启动网络开机功能支持。

此选项只有在「Fast Boot」设为「Enabled」或「Ultra Fast」时,才能开放设置。

🔑 CSM Support

此选项提供您选择是否启动UEFI CSM (Compatibility Support Module)支持传统电脑开机程序。

» Disabled 关闭UEFI CSM, 仅支持UEFI BIOS开机程序。

» Enabled 启动UEFI CSM。(预设值)

🔑 LAN PXE Boot Option ROM (内建网络开机功能)

此选项提供您选择是否启动网络控制器的Legacy Option ROM。(预设值: Disabled)

此选项只有在「CSM Support」设为「Enabled」时,才能开放设置。

🔑 Storage Boot Option Control

此选项提供您选择是否启动储存设备控制器的UEFI或Legacy Option ROM。

» Disabled 关闭Option ROM。

» UEFI Only 仅启动UEFI Option ROM。(预设值)

» Legacy Only 仅启动Legacy Option ROM。

此选项只有在「CSM Support」设为「Enabled」时,才能开放设置。

🔑 Other PCI Device ROM Priority

此选项提供您选择是否启动除了网络、储存设备及显示控制器以外PCI设备控制器的UEFI或Legacy Option ROM。

» Disabled 关闭Option ROM。

» UEFI Only 仅启动UEFI Option ROM。(预设值)

» Legacy Only 仅启动Legacy Option ROM。

此选项只有在「CSM Support」设为「Enabled」时,才能开放设置。

🔑 **Administrator Password (设置管理员密码)**

此选项可让您设置管理员的密码。在此选项按<Enter>键，输入要设置的密码，BIOS会要求再输入一次以确认密码，输入后再按<Enter>键。设置完成后，当一开机时就必需输入管理员或用户密码才能进入开机程序。与用户密码不同的是，管理员密码允许您进入BIOS设置程序修改所有的设置。

🔑 **User Password (设置用户密码)**

此选项可让您设置用户的密码。在此选项按<Enter>键，输入要设置的密码，BIOS会要求再输入一次以确认密码，输入后再按<Enter>键。设置完成后，当一开机时就必需输入管理员或用户密码才能进入开机程序。用户密码仅允许您进入BIOS设置程序修改部份选项的设置。如果您想取消密码，只需在原来的选项按<Enter>后，先输入原来的密码<Enter>，接着BIOS会要求输入新密码，直接<Enter>键，即可取消密码。

注意! 设置User Password之前，请先完成Administrator Password的设置。

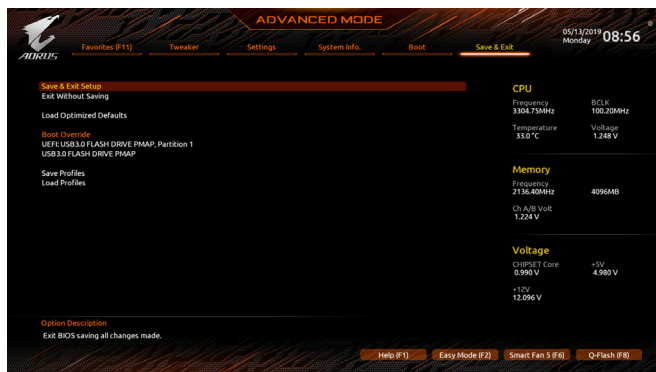
■ **Secure Boot**

此选项提供您选择是否启动Secure Boot功能及调整相关设置。此选项只有在「CSM Support」设为「Disabled」时，才能开放设置。

🔑 **Preferred Operating Mode**

此选项提供您选择进入BIOS设置程序时主画面为Easy Mode或Advanced Mode。「Auto」则为上一次进入BIOS时的模式。(预设值: Auto)

2-8 Save & Exit (储存设置值并结束设置程序)



Save & Exit Setup (储存设置值并结束设置程序)

在此选项按<Enter>然后再选择「Yes」即可储存所有设置结果并离开BIOS设置程序。若不想储存，选择「No」或按<Esc>键即可回到主画面中。

Exit Without Saving (结束设置程序但不储存设置值)

在此选项按<Enter>然后再选择「Yes」，BIOS将不会储存此次修改的设置，并离开BIOS设置程序。选择「No」或按<Esc>键即可回到主画面中。

Load Optimized Defaults (载入最佳化预设值)

在此选项按<Enter>然后再选择「Yes」，即可载入BIOS出厂预设值。执行此功能可载入BIOS的最佳化预设值。此设置值较能发挥主板的运行性能。在更新BIOS或清除CMOS数据后，请务必执行此功能。

Boot Override (选择立即开机设备)

此选项提供您选择要立即开机的设备。此选项下方会列出可开机设备，在您要立即开机的设备上按<Enter>，并在要求确认的信息出现后选择「Yes」，系统会立刻重开机，并从您所选择的设备开机。

Save Profiles (储存设置文件)

此功能提供您将设置好的BIOS设置值储存成一个CMOS设置文件(Profile)，最多可设置八组设置文件(Profile 1-8)。选择要储存目前设置于Profile 1~8其中一组，再按<Enter>即可完成设置。或您也可以选择「Select File in HDD/FDD/USB」，将设置文件复制到您的储存设备。

Load Profiles (载入设置文件)

系统若因运行不稳定而重新载入BIOS出厂预设值时，可以使用此功能将预存的CMOS设置文件载入，即可免去再重新设置BIOS的麻烦。请在想载入的设置文件上按<Enter>即可载入该设置文件数据。您也可以选择「Select File in HDD/FDD/USB」，从您的储存设备复制到其它设置文件，或载入BIOS自动储存的设置文件(例如前一次良好开机状态时的设置值)。

第三章 附录

3-1 构建磁盘阵列

RAID简介:

	RAID 0	RAID 1	RAID 10
硬盘数目	≥2	2	4
总容量	硬盘数目*容量最小的硬盘	容量最小的硬盘	(硬盘数目/2)*容量最小的硬盘
纠错功能	No	Yes	Yes

事前准备:

- 两颗(以上)的SATA硬盘或SSD^(注)。(为达到上佳的性能,请使用相同型号及相同容量的硬盘。)
- Windows 操作系统的安装光盘。
- 主板的驱动程序光盘。
- U盘。

设置SATA控制器模式

A. 安装SATA硬盘

请将准备好的硬盘/SSDs分别接至主板上的SATA/M.2插座,最后再接上电源供应器的电源插头。

B. 在BIOS程序设置中设置SATA控制器模式

请确认在BIOS程序设置中SATA控制器的设置是否正确。

步骤:

电源开启后, BIOS在进行POST时,按下<Delete>键进入BIOS设置程序,进入「Settings\IO Ports」。若要制作RAID,将「SATA Configuration\SATA Mode」选项设为「RAID」,储存设置结果后请重新开机。(若要使用NVMe PCIe SSD制作RAID,请将「NVMe RAID mode」选项设为「Enabled」。)



此部份所提及的BIOS程序设置选项及其叙述,并非所有主板都相同,需依您所选购的主板及BIOS版本而定。

C. UEFI RAID 模式设置

步骤:

1. 在BIOS程序设置画面,进入「Boot」将「CSM Support」设为「Disabled」。储存设置后重开机。
2. 重开机后,请进入BIOS程序设置画面,再进入「Settings\RAIDXpert2 Configuration Utility」子选单。
3. 「RAIDXpert2 Configuration Utility」画面时,请在「Array Management」选项按<Enter>键,进入「Create Array」画面,首先在「RAID Level」选项选择要制作的RAID模式。RAID模式选项有: RAID 0(Stripe)、RAID 1(Mirror)及RAID 10(可选择的RAID模式会依据所安装的硬盘总数而定)。选择好RAID模式后,在「Select Physical Disks」选项按<Enter>键进入「Select Physical Disks」画面。
4. 在「Select Physical Disks」画面,请将想制作磁盘阵列的硬盘设为「Enabled」,再按下键移动至「Apply Changes」选项按<Enter>键。接著可回上一画面设置磁盘阵列容量(Array Size)、磁盘阵列容量单位(Array Size Unit)及是否开启读/写快取功能。
5. 设置好磁盘阵列容量后,移至「Create Array」(建立磁盘)选项。在「Create Array」选项按<Enter>键即可开始制作磁盘阵列。
6. 完成后画面将回到「Array Management」画面,即可在「Manage Array Properties」处看到建立好的磁盘阵列。例如磁盘阵列模式、磁盘阵列名称及磁盘阵列容量等信息。

(注) 若安装的是M.2 PCIe SSD,无法与其它M.2 SATA SSD或是SATA硬盘共同构建磁盘阵列。

安装RAID/AHCI驱动程序及操作系统

完成BIOS的设置后, 您可以开始安装操作系统至硬盘中。

安装操作系统

由于部份操作系统已内建RAID/AHCI控制器的驱动程序, 为确保系统性能及兼容性, 建议在安装操作系统后, 使用主板光盘「Xpress Install」功能安装所有主板驱动程序。若您要安装的操作系统需另外在安装过程中安装RAID/AHCI控制器的驱动程序, 请参考下列步骤:

1. 请将光盘中「\Boot」路径下的「Hw10」文件夹复制到U盘。
2. 由操作系统的光盘开机并执行安装操作系统的步骤, 当载入驱动程序的画面出现时, 请选择「浏览」。
3. 选择U盘, 并选择RAID/AHCI驱动程序的位置:
「\Hw10\RAID\x64」
4. 请选择「AMD-RAID Bottom Device」驱动程序并按「下一步」载入, 再选择「AMD-RAID Controller」驱动程序并按「下一步」载入所需的驱动程序。完成后, 请继续操作系统的安装。



请至技嘉网站查询更详尽的RAID设置说明。

3-2 驱动程序安装



- 安装驱动程序之前, 请先安装操作系统。
- 安装完操作系统后, 请将驱动程序光盘置入光驱中, 点选出现的「点选要针对此光盘执行的动作」信息, 接著选择「执行Run.exe」(或进入「我的电脑」, 开启光驱图示, 并执行Run.exe)。

「Xpress Install」会先自动扫描您的系统并列出建议您安装的驱动程序。您可以按下「Xpress Install」键, 自动为您安装所有勾选的驱动程序, 或按 **Install** 单独安装您所需要的驱动程序。



请至技嘉网站查询更多的软件介绍。



请至技嘉网站查询更多的疑难排解说明。

管理声明

规章注意事项

此份文件没有技嘉的书面允许将不可复制，以及不可向第三方透露文件内容，也不被使用于任何未经授权的目的。

违反前述时将被起诉。我们相信内容中所包含的信息在印刷时，于各方面是准确的。然而，技嘉将不承担本文中任何的错误或省略的责任。再则，指明此份文件里的信息是随时调整不另行通知，和不涵括未来法规的异动范围。

我们对保护环境的承诺

除了高性能产品外，所有技嘉主板均履行欧盟规章，如RoHS (电器电子设备使用某些有害物质限制指令 Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment, RoHS)及WEEE (废电器及电子设备指令Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE)环境指令，与主要全球性的安全规章要求。并需防止有害物质释放进入环境，以及使我们的自然资源使用度达到最大化。以下信息是技嘉提供如何能负责地在您的『最终产品』内回收再利用或再使用大多数的原材料。

电器电子设备使用某些有害物质限制 RoHS 指令的声明

技嘉产品无有意添加有害物质(镉，铅，汞，六价铬，多溴联苯类与多溴二苯醚类)。零件与零部件均经过仔细地选择，使符合RoHS要求。并和持续着努力发展不使用国际间禁止的毒性化学制品。

废电器及电子设备 WEEE 指令的声明

技嘉将履行欧盟法律诠释的2012/19/EU废电器及电子设备指令。废电器及电子设备指令是关于处理、收集、回收再利用与处置电器及电子设备及其的零部件。在指令下，使用设备必须标明记号、分开地收集，并和正确地处理。

WEEE 标志陈述



以下显示标志是在产品或在它的包装上标明，象征此产品不得并同其他废弃物处理。相反，废弃设备应该被带往拥有有效处理、收集、回收再利用等废弃物收集中心。废弃设备在处理时，须做好分类收集与回收再利用，将会有助于保存自然资源，并确保某种程度上的回收再利用是保护人类健康和环境。更多关于能减少废弃设备环境安全方面的回收再利用细部信息，请与您的当地政府办公室、家庭废弃物处理服务窗口、或是您购买产品的地点联系。

- 当您的电器或电子设备不再对您有用时，请将它回收到您的当地或地区废弃物管理部门去做回收再利用。
- 如果您需要进一步的在您『最终产品』中协助回收再利用、再使用，您可以在您的产品使用手册中所列出的消费者关怀专线与我们联系，以您的努力，我们将很乐意援助您。

最后, 我们建议您通过认识和使用此产品的节能特点(适用的话), 来实践其他环境友善的行动, 回收再利用此产品所交付的的内部与外部包装材(包含运输货柜), 并和正确地处理或回收再利用所使用的电池。有你的帮助, 我们才能减少生产电器及电子设备所需自然资源的数量, 尽可能减少最终产品的垃圾掩埋处置耗用, 所以一般通过确保潜在的危害物质不会释放到环境, 以及与正确的处理来增进我们的生活品质。

中华人民共和国电子信息产品中有毒有害物质或元素的名称及含量标识格式

依照中华人民共和国的有毒有害物质的限制要求(China RoHS)提供以下的表格:



关于符合中国《电子信息产品污染控制管理办法》的声明
Management Methods on Control of Pollution from Electronic Information Products
(China RoHS Declaration)

产品中有毒物质的名称及含量
Hazardous Substances Table

部件名称(Parts)	有害物质(Hazardous Substances)					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB板 PCB	○	○	○	○	○	○
结构件及风扇 Mechanical parts and Fan	×	○	○	○	○	○
芯片及其他主动零件 Chip and other Active components	×	○	○	○	○	○
连接器 Connectors	×	○	○	○	○	○
被动电子元器件 Passive Components	×	○	○	○	○	○
线材 Cables	○	○	○	○	○	○
焊接金属 Soldering metal	○	○	○	○	○	○
助焊剂, 散热膏, 标签及其他耗材 Flux, Solder Paste, Label and other Consumable Materials	○	○	○	○	○	○
These tables are prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364 本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。 ○ : The content of such hazardous substance in all homogeneous materials of such component is below the limit required by GB/T 26572. 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 × : The content of such hazardous substance in a certain homogeneous material of such component is beyond the limit required by GB/T 26572. 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求						

FCC Notice (U.S.A. Only)

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. **WARNING:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates and radiates radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult a dealer or experienced TV/radio technician for help.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: The Interference Handbook.

This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Stock No. 004-000-00345-4

Notice for 5GHz

Operations in the 5.15-5.25GHz band are restricted to indoor usage only. (For 5GHz only)

RF exposure statement

The product complies with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

CAUTION:

The manufacturer is not responsible for any interference caused by unauthorized modifications and/or use of unauthorized antennas.
Such changes and/or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance of this device could void the user's authority to operate the equipment.

Canada-Industry Canada (IC):

This device complies with Canadian RSS-210.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes:

- (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et
- (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Notice for 5GHz:

Caution :

- (i) the device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;
- (ii) the maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz shall comply with the e.i.r.p. limit; and
- (iii) the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5825 MHz shall comply with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point and non point-to-point operation as appropriate.
- (iv) Users should also be advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

Avertissement:

Le guide d'utilisation des dispositifs pour réseaux locaux doit inclure des instructions précises sur les restrictions susmentionnées, notamment :

- (i) les dispositifs fonctionnant dans la bande 5 150-5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
- (ii) le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz doit se conformer à la limite de p.i.r.e.;
- (iii) le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5 725-5 825 MHz) doit se conformer à la limite de p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et non point à point, selon le cas.
- (iv) De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

Radiation Exposure Statement:

The product complies with the Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

European Community Radio Equipment Directive (RED) Compliance Statement:

This equipment complies with all the requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Directive 2014/53/EU.

This equipment is suitable for home and office use in all the European Community Member States and EFTA Member States.

The low band 5.15 -5.35 GHz is for indoor use only.

Restrictions d'utilisation en France:

Pour la France métropolitaine

2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur

2.400 - 2.454 GHz (canaux 1 à 7) autorisé en usage extérieur

Pour la Guyane et la Réunion

2.400 - 2.4835 GHz (Canaux 1à 13) autorisé en usage intérieur

2.420 - 2.4835 GHz (canaux 5 à 13) autorisé en usage extérieur

Notice for Italy:

The use of these equipments is regulated by:

1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, article 104 (activity subject to general authorization) for outdoor use and article 105 (free use) for indoor use, in both cases for private use.
2. D.M. 28.5.03, for supply to public of RLAN access to networks and telecom services. L' uso degli apparati è regolamentato da:
 1. D.L.gs 1.8.2003, n. 259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) se utilizzati al di fuori del proprio fondo e 105 (libero uso) se utilizzati entro il proprio fondo, in entrambi i casi per uso private.
 2. D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell' accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

Taiwan NCC Wireless Statements / 無線設備警告声明:

低功率电波辐射性电机管理办法

第十二條: 經型式認證合格之低功率射頻电机, 非經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原设计之特性及功能。

第十四條: 低功率射頻电机之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時, 應立即停用, 并改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻电机須忍受合法通信或工業、科學及醫療用电波辐射性电机設備之干擾。

在5.25-5.35GHz頻帶內操作之無線資訊傳輸設備, 限于室內使用。

Korea KCC NCC Wireless Statement:

5.25 GHz - 5.35 GHz 대역을 사용하는 무선 장치는 실내에서만 사용하도록 제한됩니다.

Japan Wireless Statement:

5.15GHz帯～5.35GHz帯: 屋内のみの使用。

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

[illegible]

技嘉主板售后服务及质量保证卡

亲爱的用户,感谢您选用技嘉科技的主板产品,选择技嘉——创新科技,美化生活。

为了确保您能够充分享有技嘉科技为您提供的完善售后服务支持,请您在购买技嘉科技产品后认真阅读本质量保证卡的说明并妥善保存此说明。

关于技嘉主板售后服务及质量保证卡说明如下:

1. 技嘉科技的主板产品在中华人民共和国境内(不包括港澳台地区)由宁波中嘉科贸有限公司总经销。
2. 技嘉公司对中国大陆地区(不含港澳台)发售,经合法认证授权渠道销售给消费者的技嘉主板提供3年(涵盖三包法规定的保修期间)免费保修服务。如参加4年质保活动的,则按官网注册时间延迟保修期。非授权认证商户(详情请访问技嘉官网)无法完整享受厂家提供的售后服务(免费三年质保)。
3. 技嘉公司对中国大陆地区(不含港澳台)发售的技嘉主板依国家三包法规定提供保修服务。
 - (1) 消费者出具正规购买发票或国家认可的有效凭证可享受全国联保。
 - (2) 如消费者无法出具正规购买发票或国家认可的有效凭证,则需送至原购买经销商接受保修服务。
4. 技嘉主板售后服务及质量保证卡仅适用于在中华人民共和国境内(不包括港澳台地区)通过合法途径购买的技嘉主板产品。
5. 根据中华人民共和国部分商品修理更换退货责任规定(三包法),用户在使用本公司主板产品过程中,若主板产品出现下列情况,本公司将不承担保修义务:
 - A. 超过技嘉提供的有效保修期限;
 - B. 未按产品使用手册的要求使用、维护、保管而造成的损坏;
 - C. 擅自改动、自行维修、组装不当而造成的产品损坏;
 - D. 使用未经合法认证的扩展部件而造成的产品损坏;
 - E. 遇不可抗力(如:水灾、火灾、地震、雷击、台风等)或人为的操作使用不当造成的损害;
 - F. 非正常的使用方式或环境造成电路板或部件划伤、扭曲、腐蚀、生锈、氧化、断裂等外观不良;
 - G. 有明显人为损坏痕迹,如:PCB板断裂,板弯,线路划断,CPU角座损坏等
 - H. 把主板作为特殊测试用途,对内存,显卡,USB,网口插槽长时间进行不正当插拔造成主板的异常损坏;
 - I. 产品序列号标贴遗失,破损,涂改导致无法辨认序列号,或与实际产品实物不符;
6. 技嘉主板产品技术支持服务指导
 - A. 如果您在使用技嘉主板产品过程中遇到问题,可以先通过查阅产品用户手册寻找答案。
 - B. 您也可以直接访问技嘉官方<http://www.gigabyte.cn/>或直接拨打技嘉科技800主板免费服务热线:800-820-0926进行咨询(未开通800电话或手机无法拨打800的地区,请拨打021-63400912)。服务时间:星期一至星期五9:00-18:00法定节假日除外。(技嘉科技800主板免费服务热线由技嘉科技授权宁波中嘉科贸有限公司成立)。
7. 技嘉主板产品送修服务指导
 - A. 当确认您所使用的技嘉主板产品由于硬件故障需要维修服务,在送修前请务必告知您所使用的主板产品型号,BIOS版本,搭配的配件配置,详细的故障现象等信息,方便技嘉工程师能够帮助您更加准确快速的判断出故障的原因。
 - B. 如购买时经销商向您承诺的服务范围大于技嘉提供的服务范围,超出部分的服务,请联系经销商以取得详细服务咨询。
 - C. 产品送修时,请以原厂包装材料或其他适合材料(如纸箱、气泡袋等)包装,送修主板需加置CPU保护盖,以免运送途中发生损坏。如是因包装不当导致运送中发生的损坏,本公司将恕不提供保修。随产品的耗材,赠品及包装材料等均不在保修范围内。
8. 申请质保售后服务时请同时出示本质保卡和有效购买凭证。
9. 质量保证卡必须加盖经销商印章方为有效。
10. 申请质保售后服务请联系技嘉科技授权的当地代理商。
11. 本公司在法律允许的范围内保留对《技嘉主板售后服务及质量保证卡》增加、删减、修改及解释的所有权利,并于本公司官方网站上公告后生效。

经销商印章

技嘉科技印章



合格证

GIGABYTE®

www.gigabyte.cn



技嘉科技全球服务网

• 技嘉科技股份有限公司

地址：新北市 231 新店区宝强路 6 号

电话：+886 (2) 8912-4000，传真：+886 (2) 8912-4005

技术服务专线：0800-079-800，02-8913-1377

服务时间：

星期一～星期五 上午 09:30～下午 08:30

星期六 上午 09:30～下午 05:30

技术 / 非技术问题支持：<https://esupport.gigabyte.com>

网址 (英文)：<https://www.gigabyte.com>

网址 (中文)：<https://www.gigabyte.com/tw>

• 宁波中嘉科贸有限公司 - 中国

技术服务专线：800-820-0926，021-63410189

服务时间 (法定节 / 假日除外)：

星期一～星期五 上午 09:00～12:00

下午 01:00～06:00

技术 / 非技术问题支持：<https://esupport.gigabyte.com>

会员网站：<https://club.gigabyte.cn>

网址：<https://www.gigabyte.cn>

• 技嘉科技服务专区 (GIGABYTE eSupport)

若您有技术或非技术(业务及市场)的相关问题时，欢迎至 <https://esupport.gigabyte.com> 询问。

